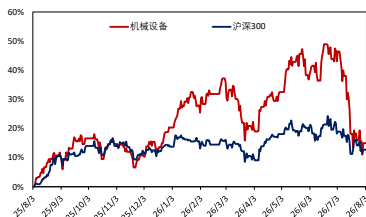


行业及产业

机械设备

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势:



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

相关研究

- 《半导体设备行业点评: 先进制程设备交期延长, 设备零部件景气延续》2026-07-27
- 《光通信设备行业点评: 高速光模块渗透提速, 测试设备需求加速释放》2026-07-20
- 《半导体设备行业点评: 存储原厂 Capex 上调, 看好半导体设备景气》2026-07-13
- 《PCB 设备行业点评: 光模块 PCB 扩产潮起, PCB 设备持续景气》2026-07-06
- 《PCB 设备行业点评: TGV 玻璃基板产业化提速, 设备环节率先受益》2026-06-29

泛林半导体业绩超预期, 看好存储及先进封装设备景气

——半导体设备行业点评

投资要点:

■ **事件: 泛林半导体 Lam Research (LRCX.O) FY26Q4 业绩及 FY27Q1 指引均超市场一致预期。**公司 FY26Q4 实现营收 67.2 亿美元 (QoQ +15.1%), Non-GAAP 毛利率 52.0% (QoQ +210bps); 公司指引 FY27Q1 营收 81.0 亿美元±4 亿美元, Non-GAAP 毛利率 52.0%±1%, 营业利润率 39.5%±1%, 指引中枢高于市场一致预期。同时, 公司将 2026 年全球 WFE(晶圆制造设备)市场规模预期由约 1400 亿美元上调至 1500 亿美元区间, 并预计 2027 年行业需求仍具备较好增长基础。我们认为, 公司指引与近期全球主要晶圆厂资本开支扩张、AI 基建持续投入等行业信号相互印证, 进一步验证半导体设备景气度仍处于上行阶段。

■ **AI 资本开支对应 WFE 需求强度持续提升, 全球半导体设备行业收入可见性进一步延伸至 2027 年。**

1) AI 资本开支正沿“数据中心—芯片—晶圆厂—设备”路径持续传导。Lam 测算, 每 1000 亿美元数据中心资本开支对应约 90-100 亿美元 WFE 需求, 上调此前约 80 亿美元的估计。AI 需求已由先进逻辑进一步扩展至 HBM/DRAM、企业级 SSD、高层数 NAND 及先进封装等多个环节, 叠加新增产能建设与先进节点升级同步推进, 使单位数据中心资本开支对应的半导体制造设备需求持续提升, 设备投资强度较此前进一步增强。2) **2027 年设备需求有望由新增产能建设与制程升级共同驱动, 行业订单可见性持续提升。**根据 Lam 管理层披露, 头部客户已围绕新增晶圆厂及洁净室投产节奏, 与设备厂商提前规划 2027 年及以后设备采购, 相关订单已按照正常甚至更长交付周期推进。预计至 2027 年底, 全球逻辑及存储领域仍将有 8-10 座新晶圆厂陆续投产, 新增洁净室将持续释放设备安装需求; 同时, 三星、SK 海力士、美光及台积电等主要晶圆厂均维持中长期扩产规划, 支撑全球设备需求延续高景气。在设备厂提前锁定订单、扩大备货并保障交付能力背景下, 核心零部件采购通常先于整机交付释放, 零部件供应商有望率先受益于本轮全球半导体设备景气上行。

■ **年设备景气仍以存储为主, 先进封装有望成为第二增长曲线。**

1) **前道设备方面, 存储仍将是 2027 年设备投资主线。**Lam 预计 2027 年设备终端需求呈现“DRAM > 先进逻辑 > NAND”的增长格局: DRAM 受 HBM 持续扩产及 1y 等先进节点升级驱动, 设备需求弹性最大; 先进逻辑受 2nm、3nm 及 GAA 架构量产推动, 先进制程投资保持高景气; NAND 虽仍保持增长, 但当前资本开支以 200 层以上产线升级为主, 大规模新建产能释放相对靠后, 因此短期景气度弱于 DRAM 和先进逻辑。2) **先进封装方面, AI 芯片性能提升正由制程微缩进一步向先进封装延伸。**Lam 将 2026 年先进封装业务增速预期由 40%以上上调至 70%以上, 主要受 HBM、2.5D/3D 封装及客户提前释放产能需求驱动。随着 Chiplet、多芯片集成及面板级封装持续推进, TSV 刻蚀、铜电镀等关键设备需求有望持续增长, 先进封装有望成为继前道设备之后的新一轮资本开支重点。

■ **配置上, 建议围绕 AI 驱动下的半导体资本开支主线, 重点布局存储链设备、核心零部件及先进封装设备。**我们建议重点关注受益于 DRAM、NAND 及 HBM 资本开支增长的存储链设备及先进封装设备, 以及受益于全球设备厂备货需求提升和国产替代加速的核心设备零部件。

投资建议: 【存储设备】海外链关注应用材料 (AMAT.O)、Lam Research (LRCX.O)、KLA (KLAC.O); 国产设备链关注微导纳米 (688147.SH)、拓荆科技 (688072.SH)、精测电子 (300567.SZ)、精智达 (688627.SH)。【设备零部件】海外链关注 MKS (MKSI.O); 国产零部件链关注先锋精科 (688605.SH)、新莱应材 (300260.SZ)。【先进封装设备】关注芯碁微装 (688630.SH)、芯碁微装 (09630.HK)、盛美上海 (688082.SH)。

■ **风险提示:** AI 算力投资及终端需求不及预期; 全球晶圆厂扩产节奏低于预期; 半导体设备厂商订单增长低于预期; 核心零部件国产替代进程及客户导入不及预期。

证券分析师

王凯

S0820524120002

021-32229888-25522

wangkai526@ajzq.com

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。